

8/25

寬能帶半導體MA/FA/FT整合測試方案(4)

Integrated WBG Semiconductor Test Solutions

近年來5G通訊、電動車市場崛起，寬能帶半導體(WBG)材料如碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)功率元件嶄露頭角，於車用市場滲透率持續攀升。然而電動車安全續航力與節能效率引發關注，車載電池是否能承受大容量及高電壓、充放電時高溫耐受性、是否會因高溫引發風險，不同品質的控制器搭配電池也會在續航能力上顯示出差別，故晶片結構堅固及熱穩定性佳尤其至關重要。

筑波科技與國際大廠指定的Teradyne ETS、Tektronix產品線合作，創造前所未有的測試平台擴展能力，提供一站式的半導體MA/CP/FT測試服務，擁有高精準、高穩定度、耐高溫、高電壓(>1200V)、高電流(>100A)特性，增強高功率半導體產業的研發品質與生產效率的ROI，提供雙贏的測試設備系統軟/硬整合方案服務。

筑波科技擁有WBG材料分析與電源管理IC/module動態測試解決方案，在異質材料介面、Wafer、Epi的材料分析MA與故障瑕疵分析FA，封裝後FT整合測試品質與生產效率提升有豐富經驗，半導體EC工程中心能即時在地服務，符合客戶全方位測試需求，本次研討會將分享測試技術實務經驗。

我們邀請您與筑波科技專業團隊就相關議題和技術交流！歡迎寬能帶半導體及3DIC產業領域的廠商先進主管報名參加。

PM 1:00~1:30	Registration 報到登記	
PM 1:30~1:40	Welcome 致歡迎詞	Richard Hsieh, APAC Sales VP, Teradyne 謝順富, Teradyne 亞太區業務副總裁
PM 1:40~2:10	WBG Market Trend and Teradyne Eagle System Introduction Practice WBG 市場趨勢及Eagle 系統實務介紹	Steve Hsu, President ACE 許深福, 筑波科技 董事長 Eric Syu, BD Manager ACE 許振揚, 筑波科技 商務開發經理
PM 2:10~2:40	GaN HEMT with High Gate Stem and Thick Copper Metallization to Improve RF Performance	Edward-Yi Chang, Ph.D.& Professor, NYCU 張翼院長 國立陽明交通大學, 國際半導體產業學院
PM 2:40~3:10	WBG功率半導體之關鍵特性分析與萃取	William Wu, Sr. Account Manager Tektronix 吳道屏, 太克科技 資深業務經理
PM 3:10~3:40	Tea Break 中場休息&方案展示	
PM 3:40~4:00	Brief WBG Integrated MA/FA/FT Test Solutions 簡述化合物半導體MA/FA/FT 整合測試方案	Walter Chen, GM ACE 陳文豪, 筑波科技 總經理
Workshop Group		
PM 4:00~4:10	A: Eagle System Introduction and GaN DUT with Socket Test (Eagle 系統展示及GaN 實測)	Teradyne/ACE
PM 4:10~4:20	B: 3DIC Advanced Package Failure Analysis (FA 展示介紹)	Teradyne/ACE
PM 4:20~4:30	C: SiC/GaN Wafer MA Test Solution (Wafer 材料表面及電氣特性實測)	Teradyne/ACE
PM 4:30~4:40	D: Flexible Semiconductor Equipment Methodology (半導體設備彈性服務新思維)	Teradyne/ACE
PM 4:40~5:00	Q&A 會後討論	

活動日期: 2022年08月25日(四) PM1:00 – PM5:00

活動地點: 新竹縣竹北市生醫二路66號 筑波醫電大樓 (新竹生醫園區)

報名方式: 03-5500909 ext. 3407林小姐/ 3502 鄭小姐
service@acesolution.com.tw

線上報名: http://register.acesolution.com.tw/2022_ACE_Teradyne_ETS_0825



手機掃碼報名

Tektronix® TERADYNE



筑波科技股份有限公司
ACE.Solution Co.,Ltd.